附录：

**材料所2021年夏令营导师清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **研究单元** | **导师** | **导师类别** | **研究方向** |
| **先进电子材料研究中心** | 孙蓉 | 博导 | 电子封装材料及其成套工艺 |
| 于淑会 | 博导 | 压电、铁电、介电材料 |
| 朱朋莉 | 博导 | 模塑料、底部填充胶、纳米金属材料 |
| 张国平 | 博导 | 晶圆级封装关键材料 |
| 刘志权 | 博导 | 金属电子封装材料与可靠性服役行为分析 |
| 许建斌 | 博导 | 电子和光电子学新材料、物理和器件及扫描探针显微术研究 |
| 廖维新 | 博导 | 电子封装材料可靠性、智能材料与结构、能量收集、振动控制 |
| 鲁济豹 | 博导 | 电子材料和器件的模拟与仿真 |
| 胡友根 | 硕导 | 电磁屏蔽与导电复合材料的研究与应用 |
| 曾小亮 | 硕导 | 热管理与散热材料 |
| 贾婷婷 | 硕导 | 多功能信息材料 |
| 单良 | 硕导 | 晶圆级封装关键材料 |
| 刘睿恒 | 博导 | 半导体热电材料、陶瓷材料、复合材料 |
| 王大伟 | 硕导 | 先进电子陶瓷及相关元器件 |
| 李俊杰 | 硕导 | 纳米金属焊膏，低温互连，功率半导体器件封装 |
| 徐亮 | 硕导 | 纳米金属封装材料 |
| 罗遂斌 | 硕导 | 聚合物基电介质材料 |
| 李刚 | 硕导 | 芯片级底部填充胶材料工艺与可靠性研究 |
| 赵涛 | 硕导 | 无机纳米材料在电子封装领域中的应用研究 |
| 梁先文 | 硕导 | 银纳米线合成与应用的产业化和基础研究 |
| 王宁 | 硕导 | 电子封装功能填料 |
| 万艳君 | 硕导 | 电磁屏蔽材料 |
| 张保坦 | 硕导 | 电子胶粘剂、电磁屏蔽 |
| 刘强 | 硕导 | 临时键合材料 |
| 李金辉 | 硕导 | 电子封装聚合物材料，光敏介质材料 |
| 毛竹 | 硕导 | 环氧树脂合成 |
| 张蕾 | 硕导 | 陶瓷电容器（MLCC）及电介质材料 |
| **材料界面研究中心** | 喻学锋 | 博导 | 柔性电子材料与器件 |
| 朱剑豪 | 博导 | 等离子体技术与材料表界面 |
| 黄逸凡 | 博导 | 等离子体技术与深海探测 |
| 李佳 | 博导 | 智能光电器件与人工智能器件开发 |
| 王佳宏 | 硕导 | 磷基功能材料设计及物性研究，离子电池电极材料 |
| 周文华 | 硕导 | CRISPR核酸检测技术开发，基因检测与生物芯片开发 |
| 康翼鸿 | 硕导 | 柔性显示材料与器件 |
| 王欣 | 硕导 | 催化化学 |
| Massimiliano  Galluzzi | 硕导 | 细胞-分子生物力学, 原子力显微镜 |
| 赵海涛 | 硕导 | 机器人辅助功能材料自动化技术、材料数据挖掘与机器学习 |
| 白力诚 | 硕导 | 高效金属催化剂设计与工业应用 |
| 赵振 | 硕导 | 生物传感与磁性生物功能材料 |
| **光子信息与能源材料研究中心** | 杨春雷 | 博导 | 光电材料与器件、全固态锂电池、柔性电子器件、5G天线材料、光谱与成像仪器 |
| 钟国华 | 博导 | 新材料设计（热界面材料、金属氢化物超导材料、碳氢有机超导材料、离子电池负极材料等） |
| 冯叶 | 博导 | 红外图像传感器、激光加工技术与装备开发 |
| 李文杰 | 博导 | 电子材料与器件微观机理研究、扫描探针显微术研究、微纳光刻技术、 薄膜太阳能电池工艺与装备 |
| 陈明 | 硕导 | 柔性智能传感器、光电探测器、医用X射线源及X射线探测器 |
| 马明 | 硕导 | 纳米材料合成、光电催化界面研究、能源转化与存储 |
| 李伟民 | 硕导 | 柔性薄膜太阳能电池，叠层太阳能电池，真空薄膜材料制备工艺与设备 |
| 张杰 | 硕导 | 钙钛矿及有机太阳能电池，载流子动力学研究，叠层光伏器件 |
| **多尺度晶体材料研究中心** | 薛冬峰 | 博导 | 晶体制备，功能晶体，超容电池 |